

贾牧

男|10年以上工作经验|1983年10月|已婚

现居住于北京-朝阳区|本科|户口北京

手机: 18601020116

E-mail: wodadehencou@gmail.com



自我评价

个人技术敏感度高, 知识面“特别”广。

芯片设计开发能力:

具备全面的集成电路开发能力, 从项目需求到产品化的全流程经验, 严谨的工作态度。

密码、安全类应用:

10+年密码、安全类设备、芯片研发经验, 对公开密码、普通密码了解广泛; 对安全体系、系统安全架构、各种安全标准有深刻的理解。

科研项目管理:

具有常年带领研发团队经验, 对产品定义、市场分析方面有深入的思考, 项目进度、团队管理有充足的经验, 项目开发流程严谨规范。

工作经历

2016/10 - 至今 北京云知科技有限公司 (3个月)

IC设计经理/项目经理|25000-35000元/月

工作描述:

1. 负责区块链应用系统的系统方案设计、安全方案设计、应用设计。对目前的区块链体系提出多个安全加固方案。
2. 负责区块链交易验证、POW系统的优化设计
3. 负责多个服务于银行、企业的区块链应用项目的项目管理, 包括技术方案设计, 研发任务分工, 进度指定与跟踪, 任务检查
4. 负责对SM2算法实现进行优化, 比目前成熟的OpenSSL解决方案提升30%, 并特别针对嵌入式CPU进行优化, ARM A53上同频性能超过X86解决方案。

2005/07 - 2016/09 兴唐通信科技有限公司 (11年2个月)

集成电路实验室设计部经理|25000-35000元/月

工作描述:

多款信息安全类芯片设计开发经验

1 组建集成电路实验室, 管理设计部工作。

- 1.1 搭建实验室集成电路设计开发环境;
- 1.2 设计实验室项目开发流程;
- 1.3 管理芯片开发项目的开发进度;
- 1.4 带领设计部, 承担设计、验证、实现、测试等芯片设计开发工作;
- 1.5 具体任务的分解与发布, 任务完成的验收;

2 在一线参与设计开发工作。

- 2.1 RTL代码设计与芯片设计集成;
- 2.2 单元模块验证和系统级验证工作;
- 2.3 FPGA原型验证设计移植与调试;

2.4 芯片综合与 PT 时序、功耗分析；

3 以技术专家身份参与论证与评审工作。

3.1 公司、核高基、军队、党政芯片需求论证工作；

3.2 芯片方案设计与评审；

3.3 确定实验室发展方向与技术预研课题；

3.4 可重用设计、验证、流程积累与归档控制；

项目经验

2016/10 - 至今 区块链类应用开发

责任描述：

参与制定系统方案，并对基于比特币的区块链体系进行安全性修改；

制定项目开发计划，跟踪项目执行过程；

优化 SM2 算法在 X86 和嵌入式系统上的处理性能；

项目简介：

某商业银行积分系统的区块链实现；面向企业的融资平台区块链设计实现；特色市场交易平台的区块链实现；

2014/12 - 2016/09 05（某移动侧密码加密芯片）

责任描述：

带领整个芯片团队完成本项目。

负责整个芯片的方案设计，并进行芯片关键单元：多核可配置帧处理器设计与实现。芯片顶层集成，负责 DC，PT，Power 三个环节具体工作。

项目简介：

中芯国际 130nm 嵌入式 Flash 工艺。芯片为复杂 soc 芯片，内部除主控 CPU 外，还有一个同构多核的通信处理网络，实现高性能网络加密。

2013/12 - 2014/11 06（某移动终端 TF 卡形态加密芯片）

责任描述：

带领芯片设计团队完成本项目的芯片设计工作。

负责整个芯片的方案设计，并进行芯片关键单元：非对称 ecc 算法单元设计与实现。同时负责芯片顶层集成，负责 DC，PT，Power，Test 四个环节具体工作。

项目简介：

中芯国际 130nm 嵌入式 Flash 工艺。芯片作为 TF 卡形态，在移动终端设备中提供密码服务。芯片架构为典型的单核多层总线架构。

2012/06 - 2016/09 04（某导航类应用加密芯片）

责任描述：

带领整个芯片团队完成本项目。

负责整个芯片的方案设计，并进行芯片关键单元：专用通信接口单元设计与实现。同时负责芯片顶层集成，负责 DC，PT，Power，Test 四个环节具体工作。

并在芯片测试完成后负责芯片的产品化工作。

项目简介：

华虹 130nm 嵌入式 Flash 工艺。芯片应用于手持移动终端设备上，实现对导航数据进行处理和密码功能。

2007/01 - 2012/01 03（某终端非对称加密芯片）

责任描述：

负责整个芯片的方案设计，承担完成了 80% 系统单元实现，并负责芯片顶层集成，负责 DC，DFT，PT，Power，Test 等开发工作。

项目简介:

中芯国际 180nm 嵌入式 Flash 工艺。芯片本身为简单 soc 架构，面向终端类应用场景，如 USB key 等，提供安全认证和加密存储服务。

教育经历

2001/07 - 2005/07 北京理工大学 电子信息科学与技术 本科

语言能力

英语： 读写能力 熟练 | 听说能力 良好